

华泰联合证券有限责任公司

关于南京晶升装备股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：晶升股份
保荐代表人姓名：姚黎	联系电话：025-83387749
保荐代表人姓名：范哲	联系电话：025-83387697

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”或“公司”）的保荐机构，对晶升股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）公司报告期内业绩波动事项

公司半年度报告显示，2026年1-6月，公司营业收入4,064.83万元，较上年同期减少41.72%；归属于上市公司股东的净利润-1,176.51万元，较上年同期减少100.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,206.55万元，较上年同期减少33.95%，下降幅度较大。保荐机构知悉上述情况后，通过管理层访谈和查阅财务资料等方式对公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了解，确认公司业绩下滑的主要原因。

经核查，保荐机构认为：

报告期内，受下游碳化硅行业及光伏行业调整影响，设备产品需求减少，同时光伏及碳化硅行业竞争加剧，产品价格下滑，导致公司销售收入和利润整体下降。此外，本期公司资产减值损失金额增加，导致净利润进一步有所下降。

针对该事项，保荐机构督促公司未来进一步强化经营管理水平，保持核心竞争力，持续关注业务发展情况，及时披露相关信息。

（二）公司前期差错更正事项

2026年4月30日，公司披露了《南京晶升装备股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》《南京晶升装备股份有限公司2025年度业绩快报更正公告》，对2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2025年度业绩快报相关财务数据及披露信息进行更正。2026年8月28日，公司披露了《南京晶升装备股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，对2025年第一季度报告、2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告相关财务数据及披露信息进行了更正。

前期差错更正涉及追溯调整，对2025年年度报告披露的分季度主要财务数据及2026年第一季度报告披露的上年同期财务数据进行了更正，不影响公司2025年年度及2026年第一季度财务报表数据。

保荐机构知悉上述情况后，结合上述事项涉及的相关函件，通过管理层访谈、查阅相关业务资料等方式对公司差错更正事项进行了解，评估对公司的影响。

经核查，保荐机构认为：

公司于2025年度报告中，对1,253.39万元营业收入由总额法调整为净额法核算、对200.00万元与收益相关政府补助调整为与资产相关政府补助核算。上述更正事项未追溯至业务发生的2025年第一季度和2025年第二季度，本次予以补充更正。

针对该事项，保荐机构督促公司全面加强内控管理，进一步夯实财务核算基础，提高公司规范运作和信息披露水平，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

（三）公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2026年8月31日，公司披露了《南京晶升装备股份有限公司关于终止发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。

经核查，针对该事项，保荐机构督促公司及时披露相关信息，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

二、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入40,648,298.79元，较上年同期减少41.72%；归属于上市公司股东的净利润-11,765,105.86元，较上年同期减少100.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,065,497.30元，较上年同期减少33.95%。报告期内，受下游客户设备验收数量较少、已验收订单产品价格偏低影响，公司营业收入有所下降。同时，本期资产减值损失同比增加，导致公司盈利水平进一步下降。未来，若行业供需矛盾持续加剧，公司未来经营业绩存在持续波动乃至继续下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术研发风险

半导体材料技术指标由晶体生长设备技术能力及客户制造工艺技术能力共同实现，晶体生长设备技术能力对材料微缺陷水平、金属含量、氧含量等材料技术指标具有重要影响。

若在后续研发过程中，公司面临因产品技术及工艺无法持续升级，下游应用领域拓展不及预期，研发资金投入过高，研发进度缓慢等情形引发技术研发风险，则可能导致公司技术研发及产业化应用失败，技术研发及创新无法满足下游行业实际应用需求，创新成果转化产品无法满足客户需求，已投入研发创新成本无法实现预期收益，产品市场竞争力下降等风险，进而对公司的经营规模、盈利能力等方面造成不利影响。

2、核心技术人员流失或短缺的风险

随着国内半导体设备行业持续快速发展，行业竞争日益激烈，专业技术人才的需求也将不断增加，若公司不能持续为技术人才提供良好的激励机制和发展平台，公司将面临核心技术人员流失或短缺的风险，从而对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

（三）经营风险

1、经营规模风险

未来期间，若公司新增投入研发、管理、销售等生产经营资源无法有效实现业务转化，投入成本效益不及预期，将对公司经营业绩带来持续不利影响。与此同时，公司生产经营面临下游产业、客户发展速度及产业化应用不及预期、行业竞争加剧及市场竞争力下降、技术研发及业务发展未达预期等诸多风险，均可能导致公司报告期后存在产品新增需求减少、收入规模下滑、产品毛利率波动、经营成本上升、经营业绩下滑及亏损的风险。

（四）财务风险

1、应收账款回收风险

随着公司持续经营，如未来国内半导体产业发展速度放缓、客户经营情况等发生重大不利变化，公司将面临应收账款回款周期延长、坏账增加等风险。

2、存货减值风险

报告期期末，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品等构成。公司主要采取订单式生产和库存式生产相结合的生产模式，根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造。期末存货余额主要为根据客户订单及发货需求形成的库存商品和尚未验收的发出商品，以及通过市场研判及客户沟通形成销售预测实施的生产备货。公司产品自原材料备货至交付验收存在一定的时间周期。未来，随着公司产销规模的持续扩大，若公司无法对存货进行有效管理，因产品技术更新迭代、销售预测变动、已签订合同订单变更或取消、产品验收无法通过、产品销售价格发生重大不利变化等因素而导致公司存货积压及价值减损，存货可变现净值低于账面净值，发生存货跌价风险，将对公司资产质量、经营业绩和盈利能力造成不利影响。

3、毛利率下降风险

公司产品毛利率变动主要受不同类别产品技术附加值及定制化需求差异、市场开拓及产品定价策略、市场竞争因素、主要零部件采购规模、价格变动等因素影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率将会面临下降的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。

4、经营活动现金流量净额下降的风险

公司目前经营活动现金流量净额与净利润增长趋势不完全同步，未来随着公司购建长期资产及营运资金需求日益增加，如果客户不能及时履行产品结算义务，或公司资金周转及使用效率降低，可能导致公司出现流动性风险。

5、政府补助与税收优惠政策变动的风险

公司自成立以来，凭借多项科技成果研发转化、高端装备研制等项目收到政府补助及相关科技奖励。如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对公司经营业绩产生不利影响。

公司被认定为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业所得税的优惠税率。如果未来公司无法通过高新技术企业资格复审，或国家相关税收政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而对公司经营业绩造成不利影响。

（五）行业风险

1、市场竞争风险

伴随着中国半导体终端应用市场的不断增长，全球半导体产业第三次转移的进程，中国半导体设备、材料、制造、封测等子行业发展迅速，占全球半导体市场份额将逐步提升。一方面，国际主要半导体材料及专用设备厂商将凭借其现有的资金、技术、市场及客户优势，在国内半导体市场进一步巩固及扩大其市场份额及领先优势；另一方面，随着我国政策的大力支持，国内新增半导体材料设备厂商也逐渐加入行业参与竞争。若公司未来无法有效应对国际主要厂商和国内新进入者的双重竞争，公司的财务状况及经营成果都将受到不利影响。

（六）宏观环境风险

1、宏观经济波动及产业政策变化风险

半导体行业发展呈现一定的周期性特点，如果未来宏观经济增速下滑，终端消费市场的需求下滑，上游产业链资本性投入所形成的产能及产出大于行业应用需求，产能利用率下降，半导体材料及芯片制造厂商将减少半导体设备的采购，宏观经济及行业固有的周期性波动将对公司发展产生不利影响。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，因技术发展等因素导致产业国产化进程减速或不及预期，公司亦将面临因产业政策变化导致经营业绩下滑的风险。

（七）其他重大风险

1、法律风险

（1）知识产权争议风险

半导体专用设备行业是典型的技术密集型行业，公司存在与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，届时可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较高的法律和经济成本，将对公司的生产经营造成不利影响。

（2）诉讼或其他法律纠纷风险

报告期内，公司就与湖州东尼半导体科技有限公司的《固定资产采购合同》纠纷一案向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起诉讼。

截至本跟踪报告出具日，诉讼案件双方已就诉讼事项达成调解，并收到浙江省湖州市吴兴区人民法院送达的《民事调解书》。前期公司已按照谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备，若对方如约履行付款义务，后续收回应收账款将对公司未来利润有一定积极影响；若对方未如约履行付款义务，公司将根据人民法院《民事调解书》及相关法律法规积极维护公司权益，最终实际影响以实际执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、募投项目风险

（1）募投项目实施进度及效益不及预期的风险

公司募投项目在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，募投项目实施进度能否按期完成，或预期效益与

公司预测是否出现偏差，均存在不确定性。因此，公司募投项目存在实施进度及效益不及预期的风险。

（2）折旧、摊销费用增加导致利润下滑的风险

公司本次募投项目“总部生产及研发中心建设项目”“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”均涉及土地购置、厂房建设、设备购置等固定资产投入，相关土地、厂房、设备达到可使用状态后将根据公司固定资产、无形资产会计政策计提折旧、摊销费用。如果未来市场环境或市场需求出现重大变化，公司募集资金投资项目不能如期产生预期收益，则公司存在因募集资金投资项目实施带来固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

三、重大违规事项

截至本跟踪报告出具日，公司2026年1-6月不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2026年1-6月，公司主要会计数据如下：

单位：万元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,064.83	6,975.05	-41.72%
归属于上市公司股东的净利润	-1,176.51	-588.13	-100.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,206.55	-1,647.25	-33.95%
经营活动产生的现金流量净额	-1,759.57	-3,748.69	53.06%
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	150,237.26	150,783.44	-0.36%
总资产	183,733.04	178,802.62	2.76%

2026年1-6月，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	-0.09	-0.04	-125.00%

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
稀释每股收益（元 / 股）	-0.09	-0.04	-125.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	-0.16	-0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率（%）	-0.78	-0.37	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-1.47	-1.05	减少0.42个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	51.75	29.48	增加22.27个百分点

上述主要会计数据及财务指标的变动原因如下：

1、2026年1-6月，公司营业收入较上年同期减少41.72%，主要系受下游碳化硅行业及光伏行业调整，设备产品需求放缓，本期确认收入的批量订单减少所致；

2、2026年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少100.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少33.95%，主要系本期确认收入订单减少、资产减值损失同比增加、理财收益同比减少所致；

3、2026年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.06%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

4、2026年1-6月，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少125.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少33.33%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力情况如下：

1、公司具有先发优势

半导体材料及专用设备行业具有技术壁垒高、研发周期长、资金投入大、下游验证周期长等特点。基于上述特点，目前，国内晶体生长设备领域仅有公司及其他少数行业参与者可实现设备技术验证并批量供应晶体生长设备。此外，考虑到半导体产业链各环节的技术要求、精密程度及稳定性要求极高，通常来说，下

游芯片厂商对已通过认证的半导体设备及制备工艺均会进行稽核，硅片/衬底材料厂商对半导体设备和制备工艺的改动均需通知下游芯片厂商，待其进行审核后方可进行。由于更换半导体设备供应商需要较长的时间进行上述稽核，且存在较大的不确定性，已通过认证的半导体设备供应商可形成较强的客户认证壁垒。由于晶体生长设备对硅片/衬底的规格指标及性能优劣具有重要影响，进而对芯片制造及半导体器件的成本与性能产生重要影响，故是否已在下游客户产线投入使用并形成较强的客户认证壁垒，成为衡量晶体生长设备供应商市场竞争力的重要标准。公司无论在大尺寸半导体级单晶炉，还是碳化硅单晶炉方面都具有先发及客户认证的优势。

2、公司具有技术及研发优势

公司基于在晶体生长设备行业多年积累的专业技术及工艺，通过持续研发，对工艺技术和设备不断优化升级，同时对标国外晶体生长设备前沿技术的发展方向，在晶体生长设备设计、晶体生长工艺及控制等技术方面，形成了独创性的设计及技术，掌握了晶体生长设备设计及控制技术、热场的设计与模拟技术和半导体晶体生长工艺开发技术等核心技术，并成功应用到公司主要产品中且实现量产销售，产品技术水平国内领先，部分技术指标已达到国际主流先进水平。公司凭借自主研发的晶体生长设备技术，以及多应用领域产品技术开发经验，已在半导体级晶体生长设备领域形成丰富产品序列，可满足不同客户差异化、定制化的晶体生长制造工艺需求。同时，公司提供的晶体生长设备已在下游客户产线批量投入使用，得到了众多客户的认可。公司持续对晶体生长设备进行研发，积累了大量的研发经验和技術储备，有助于公司进一步提升技术水平优势和竞争优势。

为推进半导体设备国产化进程，公司已建成2000平米超洁净实验室，实验室涵盖了从碳化硅粉料合成、晶体生长、晶锭切割、衬底磨抛、外延生长、外延片检测等全实验流程。该实验室的投入使用，为公司生产的各类型设备提供了原位验证平台，结合工艺团队的配方优化、信息反馈，助力公司加速产品迭代、优化提升产品性能。

3、公司具有优质客户资源优势

晶体生长设备作为半导体产业链的基础和起点，其设备供应商的市场竞争力

主要体现于设备的研发设计、晶体生长工艺积累及下游厂商的认可程度，市场竞争结果体现为设备供应商所开拓客户的实力及地位、是否获得重复和批量订单、设备是否已投入产线使用及市场份额等。

公司凭借多年的研发及工艺积累，结合“晶体生长设备—工艺技术—晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，形成了自主研发的核心技术，并覆盖了硅片厂商及碳化硅衬底的国内龙头企业或主流客户，与沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）、神工股份、合晶科技、三安光电、比亚迪等知名企业建立了合作关系。自签订首台（套）合同后，公司得到了客户的认可并获得客户的重复和批量订单，结合客户产线建设及业务开展情况，持续推进批量销售，形成了相对其他晶体生长设备企业较强的客户资源优势。此外，通过与上述半导体制造企业建立合作关系后，对客户的核心需求、技术发展的趋势等方面理解更为深刻，有助于公司选择研发方向及增强客户粘性。

4、优秀的技术研发团队是保证公司竞争优势的驱动力

公司高度重视技术研发团队建设和培养，持续引进行业内的专业人才，经过多年的积累，公司形成了一支经验较为丰富、技术水平较高的技术研发团队，能紧密跟踪国内外先进技术发展趋势，保证了公司能够不断推出新产品，并不断改进现有产品，巩固和提升公司的技术研发能力。公司按照半导体级单晶硅炉和化合物单晶炉设备等不同研发对象和项目产品，组成了分工明确的专业研发团队。在核心技术人员带领下，公司在半导体设备领域不断突破。

5、定制化服务及区位优势巩固与客户的合作关系

半导体制造企业具有高度定制化的需求，故供应商服务的快速响应和熟悉客户相关工艺的经验 and 能力尤为关键，保证了双方无障碍沟通。随着半导体制造环节向亚洲尤其是中国大陆转移，相较于国际竞争对手，在服务中国大陆半导体制造企业方面，公司在地域上更接近客户，对客户的需求及问题能够提供更快捷、更经济、更顺畅的技术支持和客户维护。此外，公司销售及研发人员会定期进行客户拜访，以了解客户需求及市场发展趋势，并对公司产品进行升级或更新换代，以保持产品的持续竞争力。

6、公司具有运营成本优势

针对海外竞争对手，由于其研发和生产人员成本较高，并且基于距离、沟通不便等因素，服务中国大陆客户的成本较高。公司的研发和生产主要位于中国大陆，拥有区位优势，人员成本相对较低。此外，公司与国内外供应商建立了较为稳定合作关系，具有较为完善的原材料供应链体系，有利于保证公司产品原材料来源的稳定性及可靠性。同时，随着本土供应链的不断成熟，给予了公司更多的采购选择，使得原材料采购更为稳定，有效降低了公司原材料采购成本及运营成本。

2026年1-6月，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2026年1-6月，公司研发投入2,103.55万元，较上年同期增加2.29%。截至2026年6月30日，公司及其子公司累计取得国内专利109项，其中发明专利43项，实用新型专利66项。此外，公司拥有计算机软件著作权8项。报告期内，公司获得新增授权专利12项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 4 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	112,491.64
其中：超募资金金额	54,010.00
减：直接支付发行费用	10,861.24
二、募集资金净额	101,630.40
减：	
以前年度已使用金额	22,161.73
本年度使用金额	0.10
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	27,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.06
其他-永久补充流动资金（含利息）	55,669.75
加：	
募集资金利息收入	366.02
其他-闲置募集资金现金管理收益	4,246.90
三、报告期期末募集资金余额	1,111.68

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,111.68 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构提示及建议公司严格按照相关法律法规的相关要求使用募集资金，重点关注募投项目进展情况，并采取积极有效措施，持续推动募投项目建设。

九、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员直

接持有公司股份及变动情况如下表：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李辉	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	22,249,406	22,249,406	-	不适用
张小潞	董事、副总经理	2,322,484	2,322,484	-	不适用
吴春生	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	1,021,080	1,021,080	-	不适用
郭顺根	董事	-	-	-	不适用
李小敏	独立董事	-	-	-	不适用
谭昆仑	独立董事	-	-	-	不适用
何亮	独立董事	-	-	-	不适用

截至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员间接持有公司股份及变动情况具体如下：

单位：股

姓名	职务	间接持股主体	间接持股数	报告期内股份增减变动量
李辉	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）	3,077,338	-
张小潞	董事、副总经理		545,545	-
吴春生	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理		1,740,824	-
郭顺根	董事		-	-
李小敏	独立董事		-	-
谭昆仑	独立董事		-	-
何亮	独立董事		-	-

此外，李辉、张小潞和吴春生等三人通过华泰晶升装备家园1号科创板员工持股集合资产管理计划持有公司股票，由私募基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司管理，无需穿透计算资产管理计划份额持有人拥有公司权益的份额。截至2026年6月30日，上述专项资产管理计划持股249,374股。

截至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结、减持的情形。

十、特别表决权事项

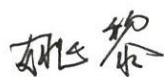
不适用。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京晶升装备股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



姚黎



范哲

华泰联合证券有限责任公司

2026年 9月 10日

